**金像電子股份有限公司獎助學金**

**檢附文件查核表**

|  |
| --- |
| **注意事項** |
| 1. 申請表和相關文件，請於**9月30日前**以「掛號」方式(郵戳為憑)寄送至：320桃園市中壢區西園路113號 金像電子股份有限公司 人力資源部 收 (**需註明「申請金像獎助學金」**)
2. 寄送前請務必再次確認以下資料是否完備，並以迴紋針Paperclip emoji clipart. Free download transparent .PNG | Creazilla固定整份文件即可，毋須裝訂。
3. 擺放順序如下：
 |
| **項目** | **是否****完成** | **檢查情形** |
| 1. 獎助學金申請表 | □完成 | 如 附表一，簽名欄位需親筆簽名 |
| 2. 學生證及身分證正反面影本，各乙份 | □完成 | 如 附表二 |
| 3. 歷年成績單正本 | □完成 | 需包含學業成績平均分數、名次證明，並加蓋學校印信 |
| 4. 獎懲紀錄證明 | □完成 | 無「過」級以上懲處記錄，並加蓋學校印信 |
| 5. 自傳 | □完成 | 500字以上，需包含個人優/劣勢、未來自我規劃等說明，如 附表三 |
| 6. 教授推薦函乙份 | □完成 | 如 附表五，請教授親筆簽名加蓋章 |
| 7. 學生本人郵局帳戶影本 | □完成 | 如 附表六 |
| 8. 個資同意書 | □完成 | 簽名欄位需親筆簽名 |
| 9. 其他有利審查之資料 | □完成 | 如 : 證照、競賽語言檢定等，具PCB相關學程或證書尤佳 |
| 10. 若為清寒家庭、中/低收入戶者  | □完成 | 請檢附中/低收入戶證明 |
| **※檢附文件如缺件或內容不齊，視同不符申請資格(第9、10項除外)。** |

**附表一、金像電子股份有限公司獎助學金申請表**

※ 日期請以**西元格式**填寫

※ 本表可以書寫或電腦打字輸入，但請勿變更欄位內容/格式

※ 簽名欄位須為**本人親筆簽名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **學校名稱** |  | 3個月內2吋照片(請浮貼) |
| **系所名稱** |  |
| **學號** |   |
| **姓名** |  |
| **出生日期** |  年 月 日 |
| **性別** | □男 □女 | **申請身分** |  學士班：□四年級 五年一貫：□一年級 碩士班：□二年級 博士班：□四年級 |
| **聯繫電話** |  |
| **電子郵件** |  |
| **戶籍地址** |  |
| **通訊地址** |  |
| **兵役狀況** | □役畢 □未役 □免役，原因： |
| **前一學年成績** | **學業成績** |  | **操行成績** |  | **系所排名** |  |
| **是否受領其他有約定附帶服務義務之獎助學金** | □否 □是，名稱：□申請中，名稱： |
| **實習/工讀經驗** | **公司** | **職稱** | **薪資** | **到職** | **離職** | **離職原因** |
| **年/月** | **年/月** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **□ 本人證明以上所填寫之資料均屬實，如有不實者，將依本辦法之規定取消申請資格。****□ 本人已詳盡閱讀本獎學金辦法，願意遵守相關規定。****□ 本人同意本公司查核申請之任何相關資料。** |
| **申請人簽名** |  | **填寫日期** |  年 月 日 |

**附表二、學生證及身分證正反面影本**

|  |
| --- |
| **學生證 (正、反面影本)** |
| 學生證正面影本(請浮貼) | 學生證反面影本(請浮貼) |
| **身分證 (正、反面影本)** |
| 身分證正面影本(請浮貼) | 身分證反面影本(請浮貼) |

**附表三、自傳**

※ 本自傳表可以書寫或電腦打字輸入，欄位不足時，可自行調整

※ 自述至少500字，內容需包個人優/劣勢、未來自我規劃等說明(字數不符者，視同資格不符)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **就讀學校/科系** |  |
| **獎助學金****申請動機** |  |
| **社團經驗** |  |
| **興趣及專長** |  |
| **自述** |  |

**附表四、教授推薦函**

※ 本推薦函可以書寫或電腦打字輸入，欄位不足時，可自行調整

※ 推薦教授簽章欄位，請推薦教授**親筆簽名及蓋章**

|  |
| --- |
| **申請人資料** |
| **被推薦人姓名** |  | **系所名稱** |  |
| **推薦教授資料** |
| **推薦教授姓名** |  | **職稱** |  |
| **推薦理由** |
|  |
| **推薦教授簽章** |  |

**附表五、學生本人郵局帳戶影本**

|  |
| --- |
| 郵局存簿影本(請浮貼) |

**金像電子個人資料蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意書**

金像電子股份有限公司（以下簡稱本公司）依據個人資料保護法等相關法令規定，說明本公司蒐集、處理、利用及/或國際傳輸您於招募及在職期間所提供一切個人資料之處理準則，以及所享有之權益如下：

1.蒐集之目的：
(1) 基於人事管理目的（包括招募任用、人事行政管理、福利優惠作業、公司內部控制及稽核等行政業務），及訴訟、非訟、仲裁或其他紛爭解決事件之處理。
(2) 為履行法定義務、契約義務，以及其他法令許可目的。

2.個人資料之類別：
本公司所蒐集您及第三人之個人資料，於所涉業務執行之必要範圍內，除相關法令明文限制外，包括您的個人資料、健康檢查、保險資料、眷屬個人資料、利害關係人資料，及其他依法可得蒐集之個人資料。

3.個人資料處理、利用及/或國際傳輸之期間、方式、地區及對象：
(1) 期間：依前開個人資料蒐集之特定目的存續期間、相關法令規定或契約約定之保存期限、本公司因執行業務所必須之保存期間。
(2) 方式及地區：包括電子或紙本等形式，於本公司暨其關係企業所在地國境內之地區。
(3) 對象：本公司暨其關係企業；金融監理、司法、稅務與其他依法具有調查權之公務機關；因前開個人資料蒐集之特定目的作業需要之第三方。

4.您就本人之個人資料得行使個人資料保護法第3條規定之請求查詢、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、刪除等相關權利，其行使方式依法令及本公司相關規定。
 申請方式悉依本公司人力資源部規定之受理程序辦理。

5. 本公司對於個人資料之蒐集處理利用皆以尊重您的權益為基礎，並以誠實信用方式原則為之。您有權選擇是否提供個人資料予本公司，若您選擇不提供個人資料或提供不完全、不正確時，本公司可能會無法為您辦理後續相關事宜，尚祈見諒。

**本人已閱讀並瞭解以上 「金像電子蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意書」內容，並同意授權 金像電子暨其關係企業於依前述告知內容蒐集、處理、利用及/或國際傳輸本人個人資料，本人提供予金像電子之資料若包含本人以外第三人之個人資料時，本人已以適當方式使該第三人知悉其個人資料會提供與 貴公司於本同意書之範圍內，進行蒐集、處理、利用及/或國際傳輸。**

簽名:

中華民國                         年                      月        日

AP-11-01-01